データシート

MicroBeam コネクター & ケーブルアセンブリー ›

最大データ転送速度112Gbps、12または16差動ペア (DP) 構成に対応し、卓越したシグナルインテグリティ (SI) を実現した、高密度ニアチップアプリケーション向け低背、高性能コネクター & ケーブルアセンブリー。嵌合時の全体高さ7.00 mm未満の小型設計の実現により他コンポーネントとの干渉を低減、エアフローと熱管理を改善した製品です。

特徴&利点

熱管理の改善
嵌合時高さ7.00 mm未満の
低背構造により、電線を
ヒートシンク下に収めてエアフローを
最大化し、冷却性能を改善。

安定した性能を保証
金属製ケージ & カバーによる
堅牢設計で機械的な強い力に
耐え、損傷を防止、安定動作を
維持。

組み立て & 保守作業がシンプル
ツールやスキル研修なしでも簡単かつ
直感的に挿入、嵌合、抜去を行える
設計により、システムのダウンタイムの
短縮や誤嵌合などの作業ミスを低減。

極数	12 または 16差動ペア
最大データ転送速度	112Gbps
嵌合高さ	7.00mm未満
最大定格電流	0.75A (1ピンあたり)
電線寸法	31 AWG Twinax
使用温度範囲	-40 ～ +85°C

高速データ転送速度と、卓越したシグナルインテグリティを実現
最大データ転送速度112Gbpsに
対応。シグナルインテグリティを
最適化するTwinaxを使用した
BiPassケーブルを使用し、市場の
需要を満たす接続性能を実現。

高密度アーキテクチャをサポート
小型設計によりチップへの
複数コネクターの配置が可能、
チャネルの高速化を実現。

アプリケーション

ネットワーク
Ethernetスイッチ
AI用ハードウェア
パッチパネルへの高速ケーブル接続

Ethernetスイッチ

AI用ハードウェア

パッチパネルへの
高速ケーブル接続

データシート

MicroBeam コネクター & ケーブルアセンブリー ›

製品特徴・仕様

参考データ
パーツシリーズ番号: ソケット—219030
ケーブルアセンブリー —221633、221635
梱包形態: エンボステープ & リール (ソケット)
寸法単位: mm
RoHS: 準拠
ハロゲンフリー: 適合

電気的性能
最大定格電圧: 29.9V RMS
最大定格電流: 0.75A (1ピンあたり)
接触抵抗: 20 mΩ以下 (初期値)
耐電圧: 300V AC RMS
絶縁抵抗: 1,000 MΩ
インピーダンス: 92.5 Ω

耐環境性能
昇温: 85°C以下 (0.75A、
全信号コンタクトを直列に接続)
高温加速寿命: EIA-364-17 method A, cond. 4
熱衝撃: EIA-364-32 method A, cond.1
機械的振動: EIA-364-28, cond. VII
機械的衝撃: EIA-364-27, cond. A
温湿度サイクル: EIA-364-31, method IV
混合ガス流腐食試験: EIA-364-65 class IIA
熱擾乱: EIA-364-110, cond. A, duration A
耐塵: EIA-364-91

機械的性能
嵌合力(ソケットカバー閉鎖力): 50N以下
抜去力(ソケットカバー開放力): 30N以下
耐久挿抜回数: 100回以上

材質
ハウジング: LCP
ウェーハ: LCP
ケーブルヘッダーカバー: ステンレス鋼
ソケットカバー & サイドシールド: ステンレス鋼
ケーブルヘッダー保護カバー: 透明PET
コンタクト: 銅合金
めっき: 接点部—ニッケル下地金めっき0.76µm以上
ソケットSMTテール部—ニッケル下地金フラッシュ
ソケットサイドシールド部—ソルダブルニッケル
ケーブル: 31 AWG twinax
使用温度範囲: -40 ～ +85°C

www.molex.com

Molexは、アメリカ合衆国におけるMolex、LLCの登録商標であり、他の国々でも登録されている場合があります。ここに表示されているその他すべての商標も該当する所有者に帰属します。
Order No. 987652-7912 USA/0k/GF/WTC2024.10
©2024 Molex